【Characteristics】A part of the copper foil of CCL remains under a little hard adhesive material.

【原因・判断ポイント・発生工程】銅めっき前の基板銅箔表面に付着した粘着物がＥＴレジストとなって出来たもの（銅めっき前～ＥＴ工程）

【原因、判断要点、发生工序】在镀铜前，铜箔表面附着的粘性物成为 ET 剂而引起的（镀铜前 ~ ET 工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】An adhesive material attached on the copper foil prior to copper plating act as an etching resist to cause the defect. (Before copper plating – etching process)

【コメント】
顕微鏡倍率×

【注释】
显微镜倍率 ×

【Coments】
Magnification: ×

【コメント】
顕微鏡倍率×

【注释】
显微镜倍率 ×

【Coments】
Magnification: ×

1-5-2　ET 残り突起／ ET 残留的凸出 / Caused by incomplete etching

1-5-2-1　回路形状不適突起／线路形状异常的凸出 / Projected conductor by improper pattern configuration

【特徴】コーナの内側や導体間隔の狭い部分、導体間隔が急変して狭くなっている部分等に出来ている裾残り状突起、ＥＴコンベア進行方向に直交する導体間隔部に多い。ロット全数に発生が見られる

【特征】在拐角内侧或者导线间距变窄、抑或导线间距突然变窄的部位出现锯齿状的凸出，多数发生在 ET 传送带方向的正交的导线间距部位，发现时整个批号都异常。

【Characteristics】A tailing projected conductor occurring on the inside of the corner of conductors or the areas where conductor spacing is narrow and is narrowed down abruptly. It often grows at spaces between conductors orthogonal to the moving direction of the etching conveyor. All the products in a lot are affected.

【コメント】
顕微鏡倍率× 175

【注释】
显微镜倍率 × 175

【Coments】
Magnification: ×175

【コメント】
顕微鏡倍率×

【注释】
显微镜倍率 ×

【Coments】
Magnification: ×

【原因・判断ポイント・発生工程】導体間隔の狭い部分等、ＥＴ液の流れが悪くなることによってＥＴが阻害されて出来たもの（ＥＴ工程）

【原因、判断要点、发生工序】ET 液在导线间距小的部位的流动差，妨碍 ET 所引起的（ET 工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】The flow of etchant is not smooth at a narrow conductor spacing, and etching there is obstructed, causing the defect. (Etching process)